

# 실리콘에 $\text{BF}_2$ 로 이온주입후에 Boron 이온의 일차원 및 이차원적인 분포해석

정원재

경기대학교 전자공학과

## Analysis of one- and two-dimensional boron distribution in implanted $\text{BF}_2$ silicon

Won-Chae Jung

Department of Electronic Engineering, Kyonggi University

**Abstract :**  $\text{BF}_2$  molecule 이온주입은 ULSI기술에 있어서 ultra shallow 접합형성을 위해고 P-MOS를 제작하는데 매우 유용한 기술이다. 주입된 boron 이온의 분포를 위해서 0.05 $\mu\text{m}$  나노스케일의 마스크사이즈의 패턴에 이온 주입한 결과를 일차원적인 분포해석을 위해서 UT-Marlowe tool을 사용하여 gauss 및 pearson 모델의 도핑분포를 나타내었다. 또한 이 데이터를 TSUPREM4에 적용하여 이차원적인 도핑분포와 열처리 후에 boron의 gauss 및 pearson 의 모델의 도핑분포를 본 논문에 나타내었다.

**Key Words :** Boron 이온주입기술, 컴퓨터모의실험, UT-Marlowe, TSUPREM4

### 1. 서 론

$\text{BF}_2$ 는 boron에 비해서 4.45배가 더 무겁기 때문에 boron 이온의 분포는 실리콘기판에서 더 얕은 접합을 나타내게 된다.  $\text{BF}_2$ 로 이온 주입된 boron 이온의 일차원 및 이차원적인 도핑농도분포에 관한 해석을 컴퓨터시뮬레이션을 통하여 그림으로 나타내었다. 본 연구에서는 0.05 $\mu\text{m}$  나노사이즈의 마스크에  $\text{BF}_2$ 를 실리콘기판으로 이온주입 하였다. 반도체 나노기술을 컴퓨터모의공정실험을 통하여 일차원 및 이차원적인 분포를 해석할 수가 있었다.

### 2. 컴퓨터모의실험

$\text{BF}_2$  분자 이온을 인이 도핑 되어진 n 타입의 기판농도가  $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 인 단결정 실리콘에 이온 주입된 조건은 에너지가 10 keV 이었고 불순물 주입량인 도즈는  $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$  이었다. 수직방향으로 이온빔이 입사되었다. 컴퓨터모의실험을 통한 결과를 그림 1에서 그림 3에 나타내었다. 그림 1에 boron 이온의 일차원적인 분포는 UT-Marlowe 프로그램을 이용하여 컴퓨터모의실험 한 결과이고 열처리후의 일차원 데이터는 TSUPREM4를 통하여 나타내었다. 더 좋은 statistic을 나타내기 위해서 UT-Marlowe 컴퓨터모의실험에서는 100,000개의 이온을 입력변수로 하였다. 그림 2와 3에서 이차원적인 boron 이온의 contour line은  $1 \times 10^{16}$ 에서  $1 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ 의 값으로 나타내었다. 그림 1은 주입된 boron 이온의 분포와  $\text{N}_2$  가스분위기에서 열처리후의 분포를 나타낸다. Fluorine 이온은 열처리하면 실리콘웨이퍼의 표면

방향으로 확산하면서 그것의 농도분포는 아주 수축하여 거의 다 사라지게 된다. 그러나 boron 이온은 확산현상에 의해 실리콘 벌크방향으로 깊은 tail 부분과 측면방향으로 더 넓게 퍼지게 된다. 1000°C에서 계산된 확산 계수는  $2.55 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{sec}$ 의 값을 나타내었다.

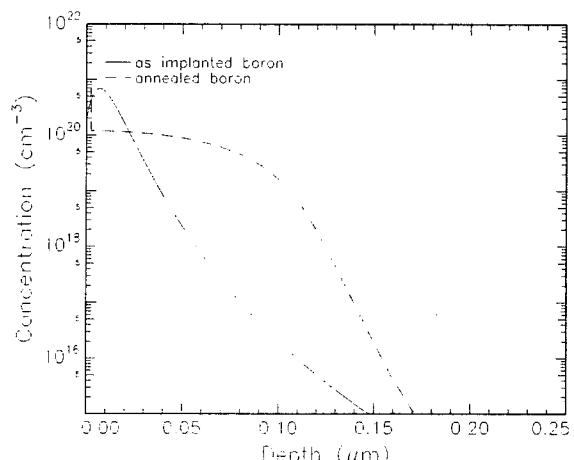
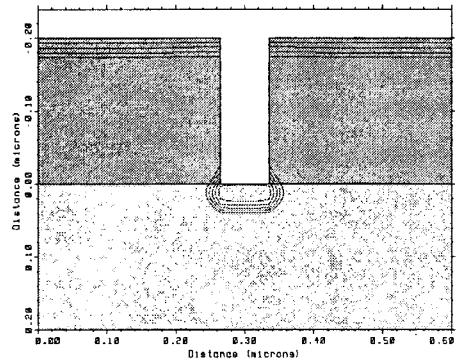


그림 1. 이온주입 후에 붕소이온의 분포와 열처리 후에 나타난 붕소 이온의 일차원적인 분포.(1000°C, 30sec)

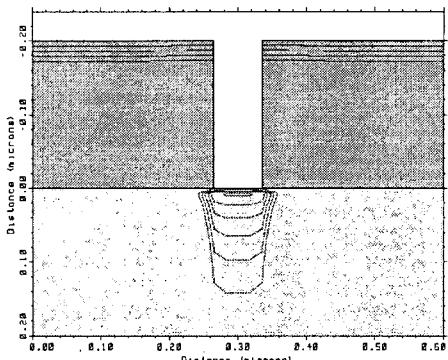
그림 1에서 나타낸 것과 같이 단결정 실리콘에  $\text{BF}_2$  분자 이온을 주입한 후에 나타나는 boron 이온의 일차원적인 분포에서 moments 값을 계산한 결과를 표1에 나타내었다.

표 1.  $\text{BF}_2$ 로 이온주입후에 봉소이온의 moments.

| $R_p$ ( $\mu\text{m}$ ) | $\Delta R_p$ ( $\mu\text{m}$ ) | $\gamma$ | $\beta$ |
|-------------------------|--------------------------------|----------|---------|
| 0.0104                  | 0.0078                         | 1.69     | 9.77    |

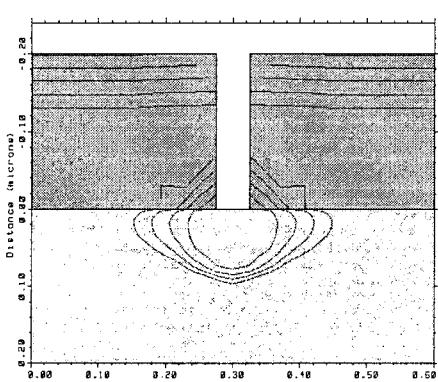


(a) Gauss model

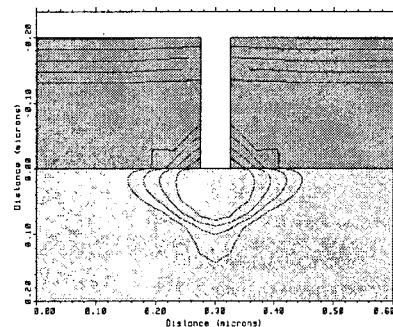


(b) Pearson model

그림 2. 마스크폭이  $0.05\mu\text{m}$ 인 경우에 봉소의 이차원적인 분포.



(a) Gauss model



(b) Pearson model

그림 3. 그림1의 조건에서 주입된 boron 이온을  $1000^\circ\text{C}$ 에서 30초간 열처리한 경우 이차원적인 분포.

### 3. 결과 및 고찰

그림 1에서 나타낸 boron 이온의 일차원적인 분포는 gauss 분포와는 다소 다른 분포인 pearson 분포를 나타내었다. 그림 2와 3은  $1000^\circ\text{C}$ 에서 30초간 열처리한 후에 이차원적인 분포를 나타내었다. 그림에서 나타내고 있듯이 나노 사이즈의 마스크에  $\text{BF}_2$ 를 이온주입하면 pearson 모델이 gauss 모델보다 기판 수직방향으로 더 깊이 침투하고 열처리 후에는 수직 및 측면 양방향으로 더 깊은 boron 이온의 분포를 나타내었다.

### 4. 결 론

컴퓨터모의실험을 통하여 나노반도체공정기술을 위한 boron 이온의 일차원 및 이차원적인 해석을 그림으로 나타내었다. 이러한 해석방법은 다양한 나노반도체소자제작 기술에 유용하게 적용되리라고 사료된다.

### 참고 문헌

- [1] Won Chae Jung and Hyung Min Kim, "A Study on Lateral Distribution of Implanted Ions in Silicon", Trans. on EEM, Vol 7, No. 4, p. 173, 2006.
- [2] Won Chae Jung, "A Study of experimental and developed model by antimony high energy implantation in silicon", . of KIEEME(in Korean), Vol. 17, No. 11, p. 1156, 2004.
- [3] Won Chae Jung, "A Study of Boron Profiles by High Energy Ion Implantation in Silicon", Vol. 15, No. 4, p. 289, 2002.
- [4] Synopsys Inc., "TSUPREM4 manual", 2006.
- [5] J. D. Plummer, M. D. Deal, and P. B. Griffin, "Silicon VLSI Technology", Prentice Hall, Inc., p. 451, 2000.